

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社
代 表 者 名 取締役社長執行役員 三浦 宗男
(コード番号 6315 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画本部長 中西 和彦
TEL (075) 692 - 0251

第4次モールドイング革命! ~半導体量産コストを“半分”に~

次世代コンプレッションモールドイング装置「INNOMS」販売開始

TOWA 株式会社は、半導体パッケージ量産の在り方を根本から変える次世代コンプレッションモールドイング装置「INNOMS (イノモス)」を、2026年8月より販売開始いたします。

「INNOMS」は、当社従来機比で量産コストを約50%低減することを目標に開発された、TOWAの次世代フラッグシップ装置です。これまで両立が難しかった高生産性・省エネルギー・省スペースを高い次元で実現し、お客様の量産コスト構造そのものを変える装置として、半導体後工程における新たなスタンダードを提案します。

記

1. 開発の背景

生成 AI とデータセンター投資の拡大を背景に、メモリ分野を軸として半導体市場が急拡大する中、半導体には「低コスト」「大量生産」「環境負荷低減」を同時に実現することがこれまで以上に求められています。

「INNOMS」は、こうした市場の要請に対し、当社が長年培ってきたコンプレッションモールドイング技術を進化させ、1台の装置が生み出す価値を最大化することを目的に開発しました。

単なる装置の高性能化にとどまらず、工場全体の投資効率・生産力・環境対応力を底上げする装置として、次世代量産ラインの中核を担う存在を目指しています。

2. 新製品の特長 (当社従来機比)



- (1) 量産コスト：約 50%削減
半導体パッケージ量産におけるコスト構造を大きく転換します。
- (2) 1台当たりの供給力を倍増
1台の装置で生産できる成形量を大幅に拡張する構成により、従来装置比で2倍の生産性を実現します。
- (3) 省スペース
高能力プレスと最適化した搬送システムを一体で設計することで、高い生産性を確保しながら設置面積を40%削減。
限られた工場スペースでも、より大きな生産力を引き出すことが可能です。
- (4) 省エネルギー
装置構成および成形プロセス全体の効率を徹底的に見直すことで、消費電力50%、消耗品材料25%を削減し、ランニングコストおよび環境負荷の低減を実現します。
- (5) 幅広いパッケージに対応
メモリ分野を中心に、ロジック、QFN、RFモジュールなど多様なパッケージに対応します。

3. 今後について

当社は「INNOMS」を、「第4次モーディング革命」を象徴する戦略製品として位置付け、グローバル市場への展開を本格化してまいります。

半導体量産のコストと生産性に新たな基準を打ち立てることで、お客様の事業成長と、半導体後工程分野における持続的な価値創出に貢献してまいります。



以上